

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 关于新产品研发进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）近期在新工艺研发上取得重要进展，公司 28 纳米逻辑芯片通过功能性验证，成功点亮 TV。为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下：

### 一、新产品基本情况

公司持续强化技术能力，以现有的技术为基础，进行 28 纳米逻辑芯片工艺平台开发。公司与战略客户紧密合作，将芯片中数字模块和模拟模块进行同步功能验证，确保该工艺平台的性能和稳定性。目前 28 纳米逻辑芯片已通过功能性验证，成功点亮 TV。

公司 28 纳米逻辑平台具有广泛的适用性，能够支持包含 TCON、ISP、SoC、WIFI、Codec 等多项应用芯片的开发与设计。后续，公司计划进一步提升 28 纳米逻辑芯片的效能和产品功耗，以满足市场对高性能、高稳定性芯片设计方案的需求。

### 二、新产品研发对公司的影响

28 纳米逻辑芯片成功通过功能性验证，为公司后续 28 纳米芯片顺利量产打下基础，并进一步丰富公司产品结构，助力公司持续稳定发展。未来，公司将继续加大技术研发投入，全面提升公司的核心竞争力，为更多客户提供更优质服务。

### 三、相关风险提示

新产品研发取得重大进展到实现大规模量产尚需一定的周期和验证流程，且

存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024年10月10日